



# 異方導電性接着剤

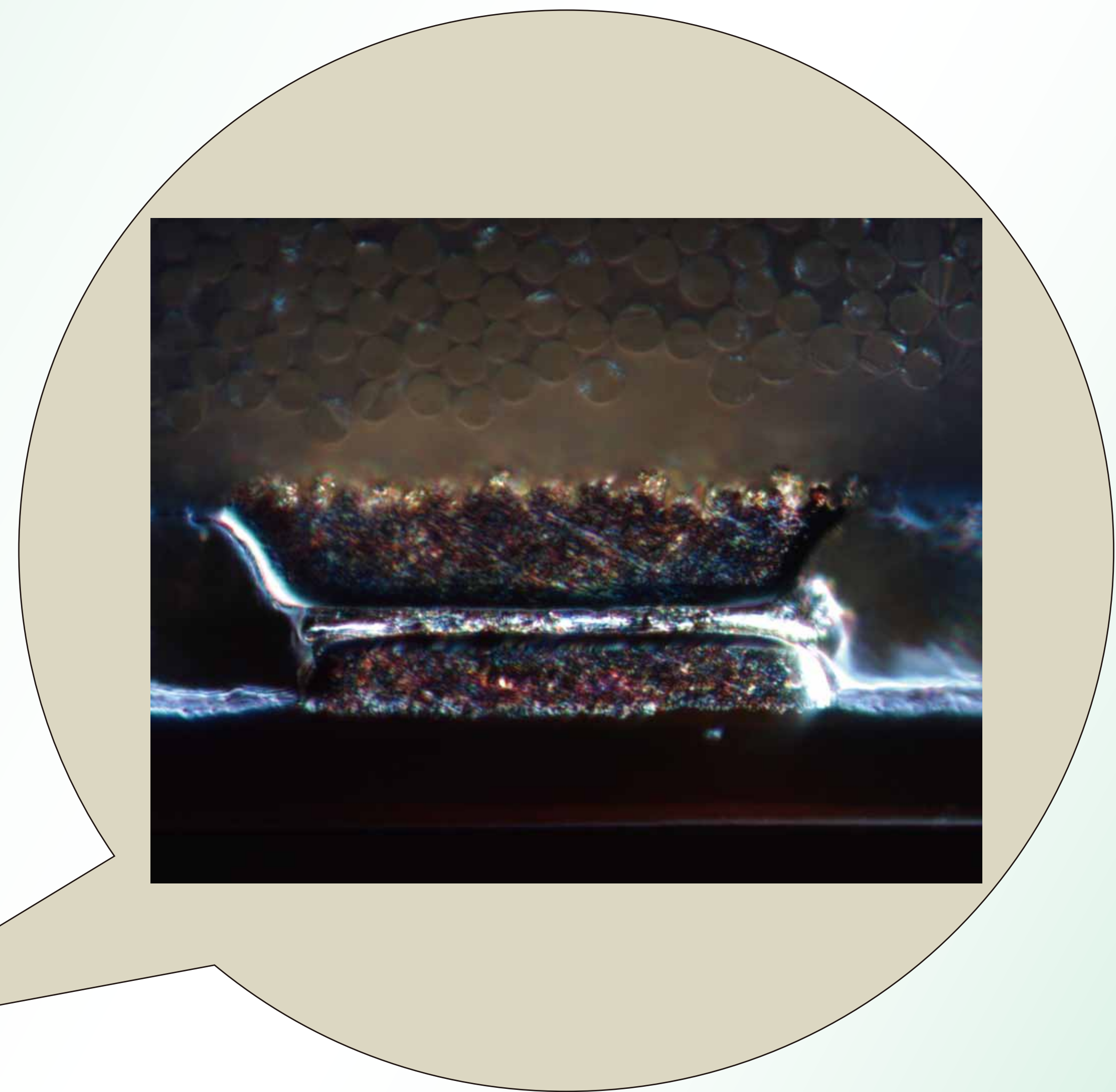
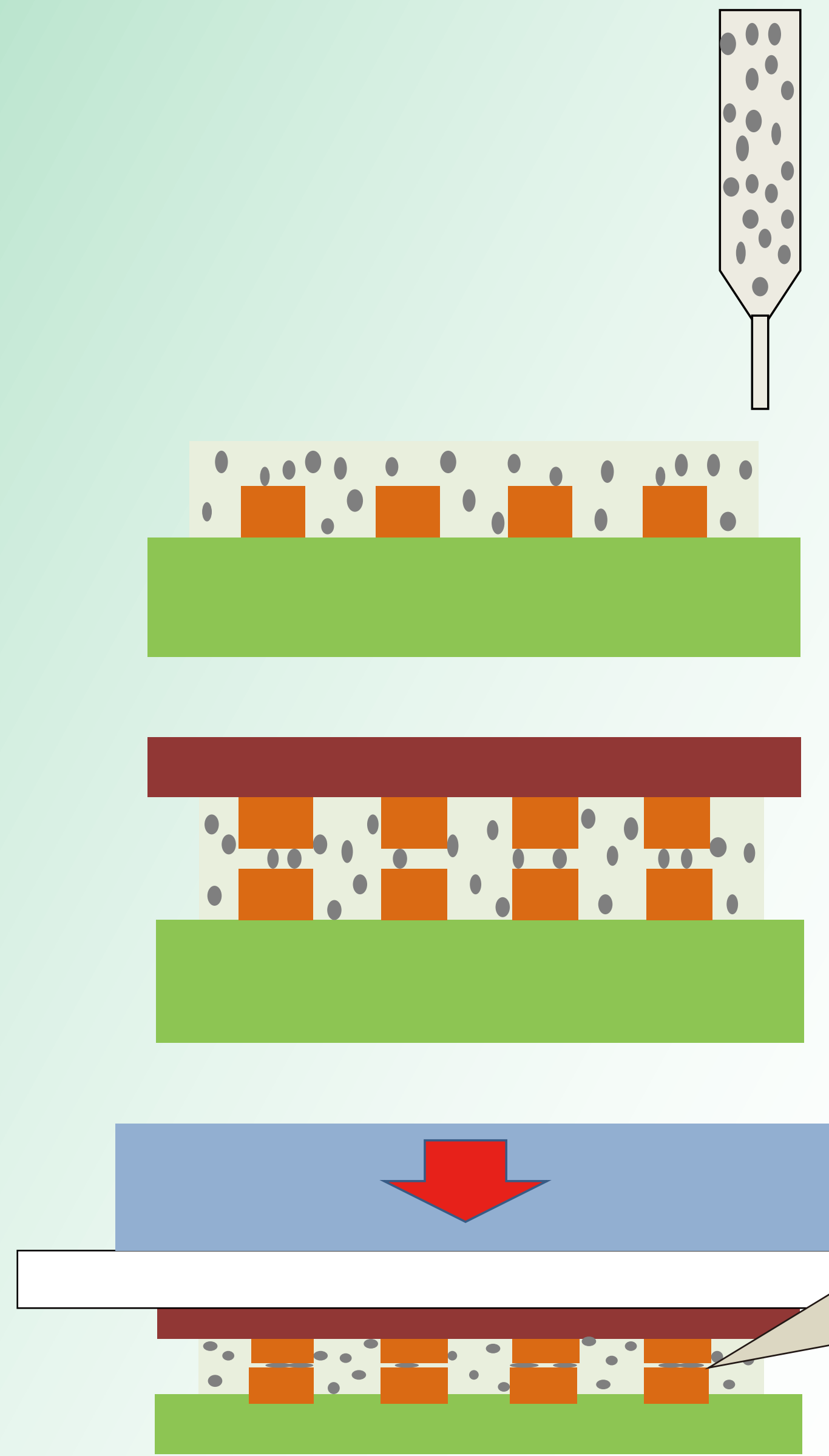
## Anisotropic Conductive Adhesives

低温かつ低圧で接続可能な異方導電ペースト  
Low pressure connection at low temperature.

塗布  
Coating

貼り合わせ  
アライメント  
Positioning and  
alignment

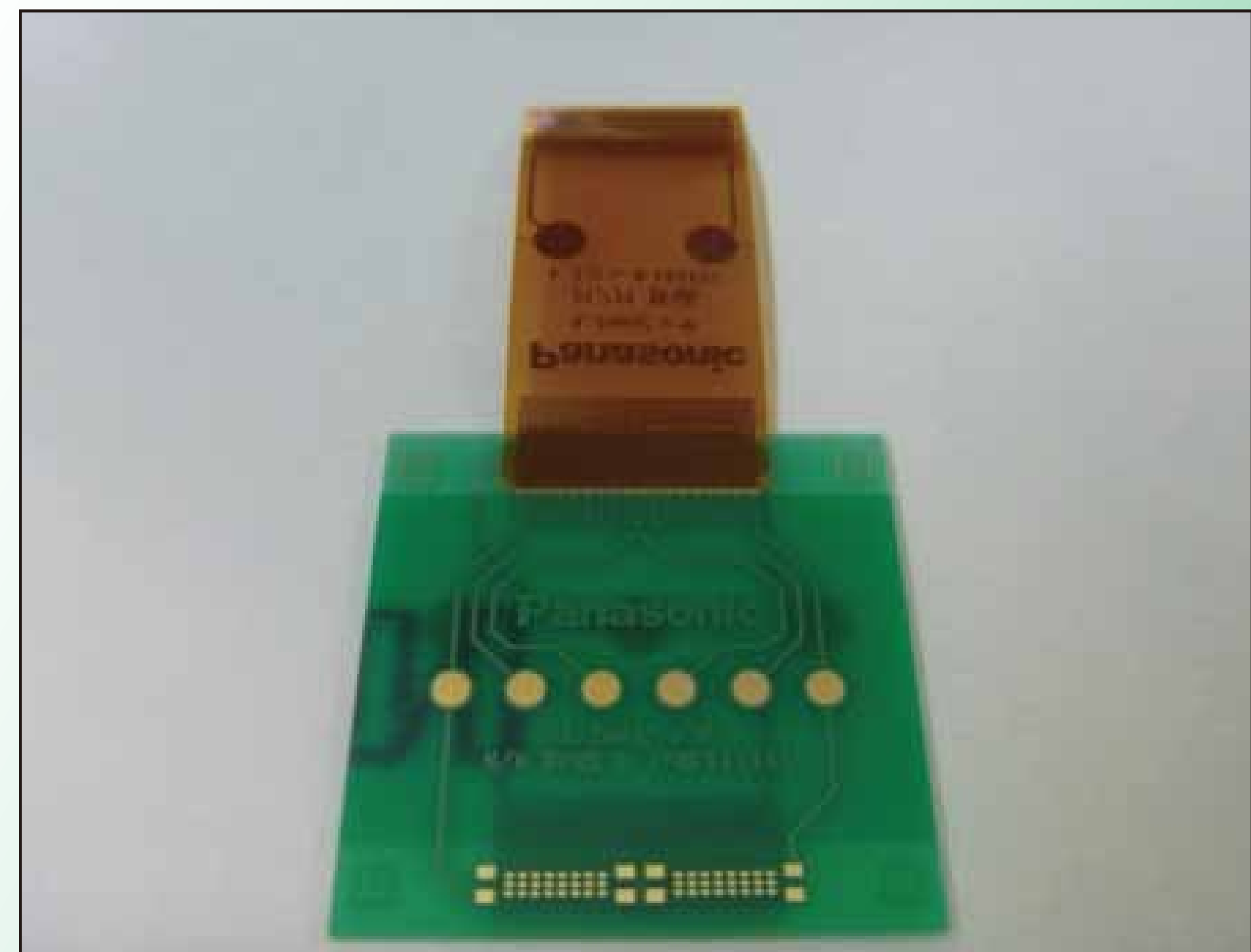
圧着  
Press lamination



### 特徴 Features

- 低温短時間での硬化が可能 (150°C 5秒) Quick cure at low temperature (150deg.C 5sec.)
- 低圧力での接続が可能 (0.8MPa) Low pressure connection (0.8MPa)
- 低背接続 (0.1mm) Thin connection (0.1mm)
- リペア接続が可能 Easy reworkability

粘度 Viscosity	Pa · s	150
TI		1.3
硬化温度 Curing temp.	°C	150
硬化時間 Curing time	秒	5
圧力 Press.	MPa	0.8
密着強度 Adhesion	90° peel	20N
絶縁性 Insulation resistance	Ω	1.00E+11



本製品は、パナソニック ファクトリーソリューションズ社のライセンスに基づくものです。  
This product is licensed by PFSC